

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

BEST AVAILABLE COPY

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 03175617 A

(43) Date of publication of application: 30.07.91

(51) Int. Cl

H01L 21/027
G03F 7/30

(21) Application number: 01315618

(71) Applicant: DAINIPPON SCREEN MFG CO LTD

(22) Date of filing: 04.12.89

(72) Inventor: MATSUI HIROSHI

(54) ROTARY-TYPE SURFACE TREATING APPARATUS FOR SUBSTRATE

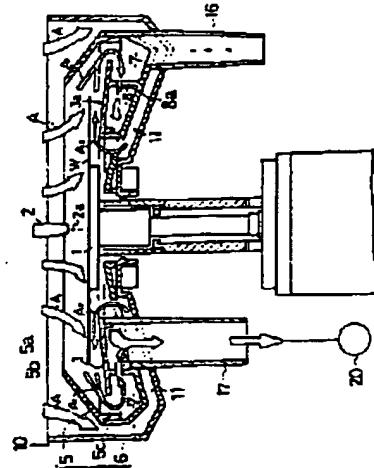
(57) Abstract:

PURPOSE: To secure the uniformity of the surface treatment of a substrate and to make it possible to prevent the attachment of the splash of treating liquid to the rear surface of a substrate furthermore by surrounding a splash preventing cup with an outer cup, forming a roundabout flow path between both cups, and communication the path to the gap between the substrate and the slant straightening surface of a circular straightening member 3.

CONSTITUTION: A spin chuck 1 holds a substrate W and the chuck 1 is rotated. A nozzle 2 supplies treating liquid to the substrate W. A splash preventing cup 4 is provided so as to surround the rotating substrate W, recovers the treating liquid and prevents the spraying of the splash of the treating liquid. An evacuation means 20 exhausts the inside of the splash preventing cup 4. Air stream flows down through an outer air inlet port 5a at the upper part of the splash preventing cup 4. The air stream is straightened through a circular straightening member 3 and guided to a lower cup 6 at the lower part of the splash preventing cup 4. The member 3 is provided at the lower side of the spin chuck 1. The splash preventing cup 4 is surrounding with an outer cup 10. A roundabout flow path 11 for passing the

air stream between both cups 4 and 10 is formed. The roundabout flow path 11 is communicated to the gap between the substrate W in the splash preventing cup 4 and a slant straightening surface 3a of the circular straightening member 3.

COPYRIGHT: (C)1991,JPO&Japio



BEST AVAILABLE COPY

⑨ 日本国特許庁 (JP)

⑩ 特許出願公開

⑪ 公開特許公報 (A) 平3-175617

⑫ Int. Cl. 5

H 01 L 21/027
G 03 F 7/30

識別記号

502

序内整理番号

7124-2H

⑬ 公開 平成3年(1991)7月30日

2104-5F

審査請求

未請求

請求項の数

1

L (全4頁)

⑭ 発明の名称 基板の回転式表面処理装置

⑮ 特 願 平1-315618

⑯ 出 願 平1(1989)12月4日

⑰ 発明者 松井 博司 京都府京都市伏見区羽束筋古川町322番地 大日本スクリーン製造株式会社洛西工場内

⑱ 出願人 大日本スクリーン製造株式会社 京都府京都市上京区堀川通寺之内上る4丁目天神北町1番地の1

⑲ 代理人 弁理士 北谷 寿一

明細書

1. 発明の名称

基板の回転式表面処理装置

2. 特許請求の範囲

1. 基板を保持して回転するスピンドルと、スピンドルの上方に設けられた板に処理液を供給するノズルと、回転する基板を用いて設けられ、処理液の回収及び処理液飛沫の飛散防止のための飛散防止カップと、飛散防止カップ内に排気する排気手段と、スピンドルの下方に飛散防止カップの上部に設けた外気取入口から流下する気流を傾斜流面で飛散防止カップ下部の下カップに導流して室内する円形導流部材とを備えて成り、飛散防止カップを外カップで囲い、飛散防止カップと外カップとの間に気流を遮断する迂回流路を形成し、迂回流路を飛散防止カップ内の基板と円形導流部材の傾斜流面との隙間に通過したこととを特徴とする基板の回転式表面処理装置

3. 発明の詳細な説明

《産業上の利用分野》

この発明は半導体基板、液晶用ガラス基板等(以下「基板」と称する)を回転させながら、その表面に例えばフォトレジスト液、現像液、エッチング液、あるいは液体ドーパント剤等を基板の上方に設けたノズルから供給することにより、基板の表面処理を行う回転式表面処理装置に関するものである。

《従来の技術》

この種の回転式表面処理装置としては、従来より例えば本出願人の提案に係る第2図に示すもの(特開昭63-77569号公報:以下「従来例1」という)、あるいは第3図に示すもの(特公昭53-37189号公報:以下「従来例2」という)が知られている。

従来例1は、第2図に示すように、基板Wを略水平に保持して回転するスピンドル101と、スピンドル101の上方に設けられた板Wに処理液を供給するノズル102と、回転する基板Wを用いて設けられ、処理液の回収と処理液飛沫の飛散を防止する飛散防止カップ104

BEST AVAILABLE COPY

特開平3-175617(2)

と、飛散防止カップ104内を排氣する排氣手段120とを備えて成り、飛散防止カップ104は上部に外気取入口105aを備え、処理液飛沫を傾斜面105bで下方へ案内する上カップ105と、上カップ105の下部周壁105cに内接する排液ゾーン107及びこの排液ゾーン107の内側にリング状の排氣ゾーン108を区画形成した下カップ106とから成り、スピンドラック101の下方には外気取入口105aから流下する気流Aを傾斜流面103aで下カップに導流して案内する円形整流部材103を設け、排氣ゾーン108を円形整流部材103の下側に設置させ、排液ゾーン107と排氣ゾーン108とを両ゾーンの隔壁に形成した絞り開口108aで連通して排氣するように構成されている。なお符号117は排氣ダクトである。

従来例2は、第3図に示すように、ケーシング204の下半部を飛散防止カップとして形成し、その内部にスピンドラック201を設け、スピンドラック201で保持した基板Wの下方に気流室

ある。

一方、従来例2は上記のような問題点はないが、排氣口217がケーシング204の側壁204bにあけられ、しかもスピンドラック201よりも上方に位置するため、排氣流Bに乘って処理液の飛沫が基板Wの上方に吹き上げられ、それが基板Wの表面へ再付着するという問題がある。なお、排氣ダクトを第2図のようにケーシング204の下部に開口することも考えられるが、その場合でも気流室内板203の下側に設けたエア噴射ノズル211から基板Wの下面にエアA₁を吹き付ける構造であるため、基板Wの周縁部より流下する気流は均一とならず乱流を生じ易い。このため、空膜を均一に、高精度で形成することができない。

本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、基板の表面処理の均一性を確保しながらも、基板の裏面へ処理液の飛沫が付着するのを防止することを技術課題とする。

《課題を解決するための手段》

本発明は上記課題を解決するために前記従来の

内板203を水平配設し、気流室内板203の下側に環状のエア噴射ノズル211を設け、基板Wの下面にエアA₁を吹きつけて、表面処理液の飛沫が基板Wの裏面に付着するのを防止するように構成されている。なお、第3図中符号220は基板Wの上面に気流Aを吹き付ける気体供給用ノズル、217はケーシング204に開口された排気口である。

《発明が解決しようとする課題》

上記従来例1は、排氣ゾーン108を円形整流部材の下側にリング形状をなすように設け、その外周に排液ゾーン107を区画形成して両ゾーン107・108を絞り開口108aで連通し、基板Wの周縁より流下する気流Aが均一となるように構成されており、フォトレジスト等の膜厚を均一に高精度で形成できるものであるが、次のような難点がある。

基板Wの周縁より流下する気流Aの一部が、基板Wと円形整流部材103との間隙に流入し、処理液の飛沫が基板Wの裏面に付着するという問題が

回転式表面処理装置を以下のように改良したものである。

即ち、前記従来例1の基板の回転式表面処理装置において、飛散防止カップを外カップで囲い、飛散防止カップと外カップとの間に上記気流を流通する迂回流路を形成し、迂回流路を飛散防止カップ内の基板と円形整流部材の傾斜整流面との間隙に連通したことを特徴とするものである。

《作用》

本発明では、飛散防止カップと外カップとの間に形成された迂回流路が、基板と円形整流部材の傾斜整流面との間隙に連通されており、基板の周縁より流下する気流によって、当該迂回流路が負圧になる。従って、この迂回流路を流通する気流は、基板の下側を周縁部へ向かって流れ、上記流下気流と合流することになるが、従来例のように吹き付けによるものではないので、流下気流の乱れは生じない。これにより、基板の表面処理の均一性は確保され、かつ基板の裏面へ処理液飛沫が付着することもない。

BEST AVAILABLE COPY

特開平3-175617(3)

（実施例）

第1図は本発明の一実施例を示す回転式表面処理装置の最断面図である。

この回転式表面処理装置は、第1図に示すように、基板Wを略水平に保持して回転するスピナック1と、スピナック1の上方に設けられた基板Wに処理液2aを供給するノズル2と、スピナック1で保持した基板の下方に配置され、流下気流Aを傾斜整流面3aで整流して室内する円形整流部材3と、回転する基板Wを囲うようにして設けられ、処理液2aの回収と処理液飛沫の飛散防止とに役立つ飛散防止カップ5と、飛散防止カップ4を囲う外カップ10と、排気手段20とを具備して成る。

飛散防止カップ4は、上部に外気取入口5aを備え処理液飛沫を傾斜面5bで下方へ室内する上カップ5と、上カップ5を着脱自在に受止め支持し、上カップ5の下部周壁5cに内接する排液ゾーン7及びこの排液ゾーン7の内側にリング状の排気ゾーン8を区画形成した下カップ6とから成る。

先ず、スピナック1に基板Wを中心合わせて吸音保持させ、排気ダクト17より強制排気する。

次いで、基板Wの上面中央部にノズル2より例えればフォトレジスト液2aを吐出させ、すぐには基板Wを回転させる。すると、基板Wの回転に伴い、その表面にフォトレジスト液の塗膜が形成され、余剰の液は基板Wの周縁から飛沫となって飛散する。この飛沫は上カップ5の傾斜面5bに衝突し、外向き約め下方に室内され、一部はさらに円形整流部材3の傾斜整流面3aに衝突し、下カップ6へ室内される。

一方、排気手段20によって排気ダクト17から強制排気されていることから、外気取入口5aから飛散防止カップ4内に流入する外気Aは基板Wの上面に沿って放射方向へ流れ、基板Wの周縁を通る流下気流Aとなり、円形整流部材3の傾斜整流面3aに沿って流下する。

他方、負圧によって迂回流路11を流通する気流Aは、傾斜整流面3aの上縁と基板Wの下面

る。

排気ゾーン8は円形整流部材3の下側にリング形状をなすように設けられ、排液ゾーン7から排気ゾーン8へは排気ゾーン8の周縁にスリット状に形成した絞り開口8aで連通し、排気ゾーン8内に設けた排気ダクト17より排気するように構成されている。なお、第1図中符号16は排液ゾーン7内に設けられた排液ドレンである。

上記外カップ10は、飛散防止カップ4を囲い、飛散防止カップ4との間に気流Aの一部を流通する迂回流路11を形成する。この迂回流路11はスピナック1で吸音保持した基板Wの下面と、円形整流部材3の傾斜整流面3aとの間に連通されており、基板Wの周縁より流下する気流A、によって当該間隙及び迂回流路11が負圧になる。つまり、この迂回流路11を流通する気流Aは基板Wの下側を周縁へ向かって流れ、流下気流Aと合流するが、吹き付けによるものではないので、流下気流Aの乱れは生じない。

次にこの装置の動作について説明する。

との間隙を通って放射状に流出し、上記流下気流Aと合流する。これにより、基板Wの裏面へ処理液飛沫がまわり込んで付着するのを防止する。そして、流下気流Aは下カップ6の排液ゾーン7を経出し、絞り開口8aによって通風抵抗を受けながら排気ゾーン8内へ流入し、排気ダクト17より排気される。

つまり、流下気流Aは、絞り開口8aを介して排気されるようになっているので、基板W上の気流Aは全方向へ均一な流れとなり、塗膜のムラも生じない。

《発明の効果》

以上の説明で明らかなように、本発明では飛散防止カップを外カップで囲い、両カップの間隙に迂回流路を形成して基板下面と傾斜整流面との間に連通したので、下記の効果を奏する。

イ. 迂回流路を流通する気流は、負圧によって基板の下側を周縁部へ向けて流れ、処理液飛沫が基板の裏面へまわり込み付着するのを防止することができる。

□、基板の下側を周縁部へ向けて流通する気流は流下気流と合流するが、従来例のように吹き付けにより流下気流の乱れを生じさせることもない、基板の表面処理の均一性を確保することができる。

1. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る回転式表面処理装置の概断面図、第2図及び第3図はそれぞれ従来例1及び従来例2に係る回転式表面処理装置の概断面図である。

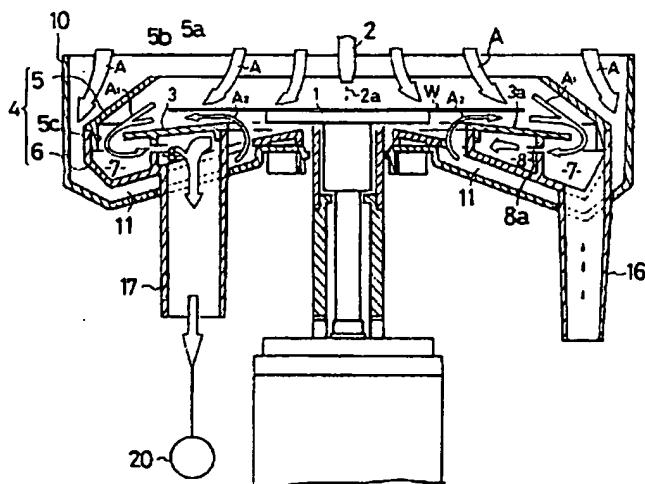
1…スピナチャック、2…ノズル、3…円形容器部材、3a…粉料壁流面、4…飛散防止カップ、5…上カップ、5a…外気取入口、6…下カップ、7…排液ゾーン、8…排気ゾーン、8a…取り開口、10…外カップ、11…逆向流路。

BEST AVAILABLE COPY

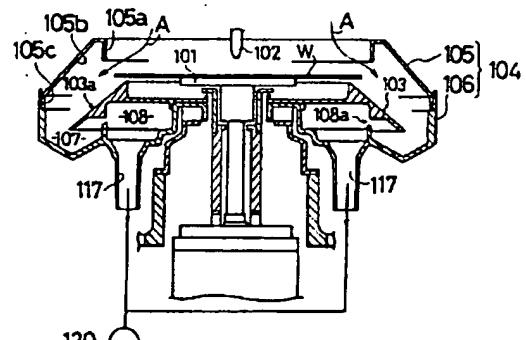
特許出願人 大日本スクリーン製造株式会社

代理人 北谷寿一

第1図



第2図



第3図

